

# ASEMI 桥堆接法GBPC5010 GBPC5010

产品名称	ASEMI 桥堆接法GBPC5010 GBPC5010
公司名称	鼎芯实业（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座38层
联系电话	13632557728

## 产品详情

编辑：ll

导读：印制线路板设计，对于电子产品来说是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序，而设计的合理性与产品质量紧密相关。强元芯电子，12年专注于电源领域，坚持用心为客户，用心生产每一个产品。现在就让强元芯电子的设计师告诉你：怎样更好地进行布局！

下面，各位小伙伴们就可以跟着强元芯设计师一起看一下怎样进行布局：

PCB板的布局：

1、印制线路板上的元器件放置的顺序：

（1）放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件，如电源插座、指示灯、开关、连接件之类，这些器件放置好后用LOCK功能将其锁定，使之以后不会被误移动；

（2）放置小器件：元器件离板边缘的距离：可能的话所有的元器件均放置在离板的边缘3mm以内或至少大于板厚，这是由于在大批量生产的流水线插件和进行波峰焊时，要提供给导轨槽使用。

2、印制线路板的走线：

印制导线的布设应尽可能的短，在高频回路中更应如此；印制导线的拐弯应成圆角，而直角或尖角在高频电路和布线密度高的情况下会影响电气性能；

当两面板布线时，两面的导线宜相互垂直、斜交、或弯曲走线，避免相互平行，以减小寄生耦合；作为电路的输入及输出用的印制导线应尽量避免相邻平行，以免发生回授，在这些导线之间好加接地线。

3、印制导线的间距：

相邻导线间距必须能满足电气安全要求，而且为了便于操作和生产，间距也应尽量宽些。小间距至少要能适合承受的电压。

如果有关技术条件允许导线之间存在某种程度的金属残粒，则其间距就会减小。因此设计者在考虑电压时应把这种因素考虑进去。

#### 4、印制导线的屏蔽与接地：

印制导线的公共地线，应尽量布置在印制线路板的边缘部分。在印制线路板上应尽可能多地保留铜箔做地线，这样得到的屏蔽效果，比一长条地线要好，传输线特性和屏蔽作用将得到改善，另外起到了减小分布电容的作用。

印制导线的公共地线形成环路或网状，这是因为当在同一块板上有许多集成电路，特别是有耗电多的元件时，由于图形上的限制产生了接地电位差，从而引起噪声容限的降低，当做成回路时，接地电位差减小。

强元芯12年来一直专注于电源整流领域，一直坚持用心为客户服务。所生产的每一个产品都经过28条先进台湾健鼎测试线的测试，确保了每一颗产品都经过严苛的检验环节，100%的保证出厂良品率。而且产品生产工艺精湛，品质好，稳定性高，价格实惠，桥堆的作用GBPC5010，性价比高，所有用过ASEMI品牌产品的客户都愿意选择我们，不愿意更换别的品牌。强元芯电子，值得你信赖！

感谢广大客户对我们的信赖与支持，我们将会再接再厉，坚持用心为客户服务，与您一起携手共同迎接未来的机遇与挑战！从心所愿，强悍出击，相信你的选择没有错。强元芯，GBPC5010，期待与您携手前进、共创辉煌！

编辑：ll

摘要：最近的娱乐新闻又刷爆“火热”话题，唯ASEMI岿然不动，有实力有品质。不相信？且看MB8S整流桥专业品质，ASEMI真芯待你！

整流桥MB8S的芯片强元芯ASEMI为何采用GPP工艺，ASEMI又是如何保证品质做到真芯的呢？

台湾大品牌ASEMI 桥堆全部采用台湾波峰GPP芯片。而不是采用以前老工艺--酸洗工艺。MB8S贴片整流桥也是使用的这种GPP大芯片，那么用这种工艺的芯片有什么好处呢？

GPP（方片）是Glassivation。passivation。parts的缩写，是玻璃钝化类器件的统称，该产品就是在现有产品普通硅整流扩散片的基础上对拟分割的管芯P/N结面四周烧制一层玻璃，玻璃与单晶硅有很好的结合特性，使P/N结获得最不错的保护，免受外界环境的侵扰，提高器件的稳定性，可信赖性极好。GPP芯片造的整流桥免去了酸洗、上硅胶等步骤，直接与整流桥的铜连接片焊接。内部结构显的比O/J芯片制造而成的小。才造成直观的、习惯性的误解。

ASEMI的整流桥全部都是采用GPP工艺，ASEMI整流桥半导体拥有世界先进的生产设备，和完善的生产管控流程，全自动一体化生产线，从芯片生产到成品焊接，完全采用智能化产线，健鼎一体化测试设备保障出厂的产品100%合格。下面我们再来了解一下MB8S的参数详情和外观尺寸。MB8S电性参数介绍

MB8S产品，在封装里有4条引线。其该型号的电性参数是：正向电流（Io）为0.5A，反向电压为800V，正向电压（VF）为1.0V，采用GPP芯片材质，里头有4个芯片，芯片尺寸都是46MIL，它的浪涌电流Ifsm

为30A，漏电流（Ir）为5uA、工作温度在-40~+150，恢复时间（Trr）达到500ns。

## MB8S尺寸参数介绍

整流桥MB8S型号它的脚间距为2.5mm，整体长度为4.7mm，高度为2.5mm，桥堆封装GBPC5010，厚度为1.1mm，其本体宽度为4.0mm，脚厚度为0.25mm。

编辑：ll

摘要：【20A整流桥】整流桥ASEMI带您见证品牌品质的奇迹。最近强元芯的客户提出，全网的20A整流桥似乎只找到了我们。当然这是有原因的，都是行业生产的秘辛。

最近强元芯的客户提出了一个发现，这个发现让他们更加相信强元芯ASEMI的实力。

起因是这样的，有一位客户搜索全网去找一款20A的整流桥，但网络当中信息极少又担心上当受骗，于是找到强元芯，发现20A整流桥似乎只找到了我们一家品牌生产商，于是果断选择了我们一款20A整流桥RS2006M。20A整流桥在整流桥行业生产中产量极少，这是事实，当然这也是有原因的，都是行业生产的秘辛。而整流桥ASEMI不为生产成品、营利目的所困，用事实用产品带您见证品牌品质的奇迹！

台产原装“ASEMI”品牌整流桥堆RS2006M是强元芯电子一直力推而且热卖的型号，其台湾的进口晶圆—台湾波峰GPP芯片，进一步切割成为一颗颗尺寸为140MIL的芯片，并装在优质PC材料一次性浇注成型的外壳里，电性参数可达20A600V，工作温度在-55 -150 之间，恢复时间仅需500n。因为专业，所以值得信赖！

## RS2006M生产工艺流程

RS2006M其生产封装工艺如下图所示，图中所示为整流桥生产过程5大生产流程，从芯片的选择，桥堆接法GBPC5010，到注塑切割，最后到了检测这一步在下图中都一一列举，若要更详细的去分解，整流桥的生产过程有12道生产工序，5道检测，无一不是保障产品的质量。

为什么都找不到网上有20A整流桥的信息呢？其实很简单，有很多厂家一直做的是代工生产，并没有自主研发的实力能力和财力，完整的规格系列代表了完善的生产规格体系以及生产实力。全网发布20A整流桥RS2006M，ASEMI整流桥将满足您采购选型的所有要求！

ASEMI(图)-桥堆接法GBPC5010-GBPC5010由鼎芯实业（深圳）有限公司提供。鼎芯实业（深圳）有限公司（www.asemi88.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鼎芯实业——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市福田区振华路鼎诚国际大厦23楼，联系人：李强。同时本公司（www.asemi.wang）还是从事整流桥型号参数，整流桥型号封装，整流桥型号价格的厂家，欢迎来电咨询。